

W20 SOLDADURA EN PASTA SOLUBLE EN AGUA

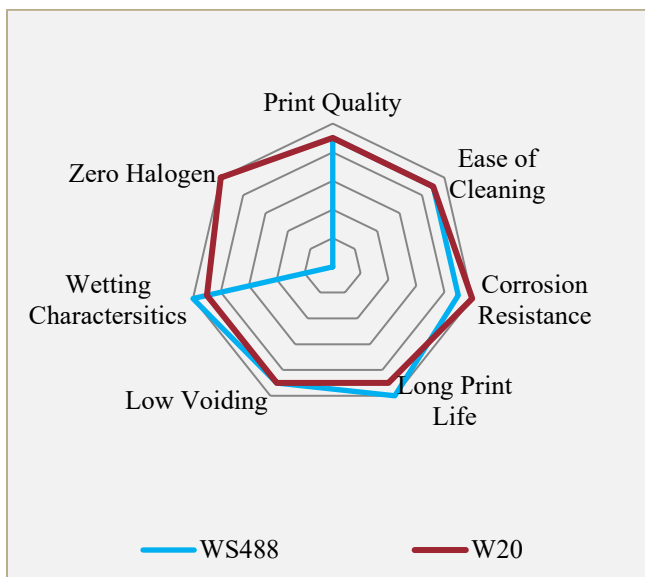
CARACTERÍSTICAS

- Cero Haluros/Halógenos conforme a J-STD-004/B
- Cumple con las normas RoHS*
- Lavado con agua desionizada (DI)
- Baja generación de espuma
- Disponible en tamaños de polvo T4 y T5
- Ventana de limpieza extendida a más de 2 semanas
- Vida útil en estencil de +8hrs.

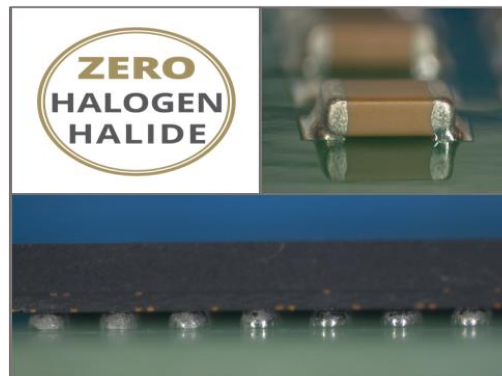
DESCRIPCIÓN

La pasta para soldadura soluble en agua W20 de AIM es una fórmula de flux con cero haluros y halógenos. W20 ha sido diseñada para mejorar el rendimiento de humectación en todas las superficies electrónicas soldables. W20 exhibe excelentes características de impresión y una vida útil en el estencil de más de 8 horas. Los residuos altamente solubles de W20 se eliminan fácilmente con agua, incluso con componentes de bajo separación (stand-off). Este producto soluble en agua para todo tipo de aplicaciones fue creado para satisfacer la demanda de la industria de una pasta de soldadura soluble en agua con cero halógenos y consistente.

CARACTERÍSTICAS



*Para aleaciones sin Plomo.



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Tiempo	Temperatura
Vida útil de pasta cerrada y refrigerada	6 meses*	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil de pasta cerrada no refrigerada	2 semanas*	< 25°C (< 77°F)

* Tamaño del polvo T4. Póngase en contacto con AIM para obtener información sobre la vida útil de T5.

No añada pasta usada a la pasta que no ha sido utilizada. Almacene la pasta usada por separado; mantenga la pasta no usada bien cerrada con el tapón interno o la tapa en su sitio. Una vez abierta, la vida útil de la pasta para soldar dependerá del entorno y de la aplicación. Consulte las guías de uso de las pastas de AIM para obtener más información. Las condiciones de aleación y almacenamiento pueden afectar a la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis W20 para obtener información específica del producto.

LIMPIEZA

Pre-reflujo: El limpiador de estenciles de AIM elimina eficazmente la soldadura en pasta de los estenciles durante el proceso. El limpiador de estenciles se puede aplicar a mano o utilizar en equipos de limpieza bajo estencil. El limpiador de estenciles no seca la soldadura en pasta y mejora las propiedades de transferencia. No aplique una cantidad excesiva de limpiador de estenciles. No aplique el limpiador de estenciles en la parte superior del estencil. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) durante el proceso, pero se puede utilizar como enjuague final del estencil.

Residuos de flux posteriores al reflujo: AIM recomienda eliminar los residuos de flux solubles en agua en un plazo de 24 horas para obtener resultados óptimos, pero pueden dejarse en la placa de circuito hasta dos semanas. La limpieza puede realizarse con agua corriente a una temperatura de entre 50 °C y 60 °C (120 °F y 140 °F), seguida de un enjuague final con agua desionizada.

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

PERFIL DE REFLUJO

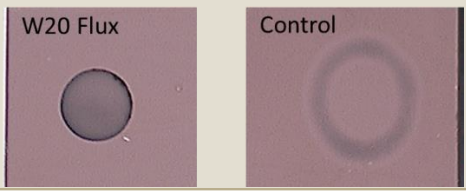
Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

IMPRESIÓN

Ajustes iniciales recomendados de la impresora - Dependiendo del diseño de la PCB y del Pad	
Parámetro	Configuración Inicial Recomendada
Presión de espátula	0.30-0.60 kg/cm (1.7- 3.4 lb. /In.) de la hoja
Velocidad de la espátula	25-120 mm/seg. (1-4.7" /seg.)
Distancia de impresión (Snap-off)	En contacto 0.00 mm
Distancia de separación PCB	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de separación PCB	3-6 mm/seg.


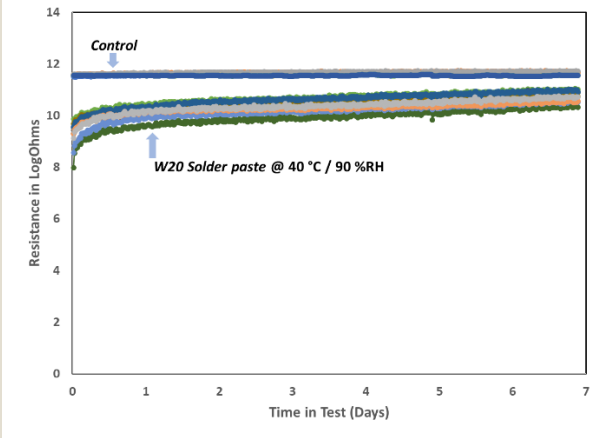
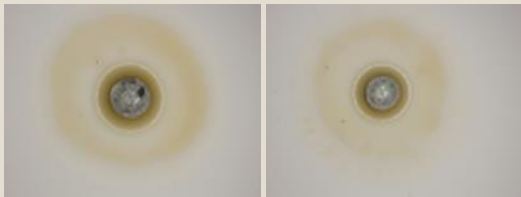
DATOS DE PRUEBAS

Nota: Todos los datos de ensayo corresponden a la formulación T4 SAC305.

Nombre	Método de Prueba	Resultados	
Clasificación IPC Flux	J-STD-004 versión actual	ORM0	
Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	MED = < 50% Avance	@ 23 °C / 55 %RH
			
Corrosión	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	Antes
			Después
Halógeno	J-STD-004B 3.5.4 EN 14582	400 ppm Típico	Libre de Halógeno
			Haluros cuantitativos

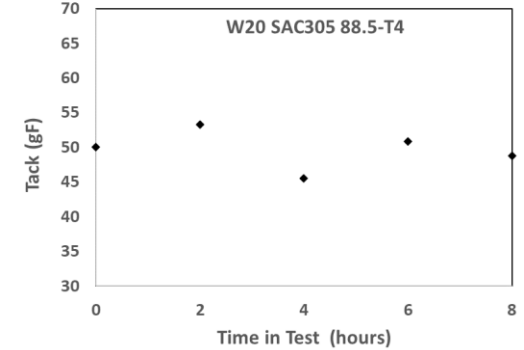
*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	No detectado	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	No Fluoruro	
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA, Todas las mediciones en los patrones de prueba exceden 100 MΩ	
Determinación del valor ácido	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	54.2 mgKOH/g flux Típico	
Viscosidad (Brookfield)	J-STD-004B 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	4500 - 850 kcps Típico (depende de la fórmula)	
Viscosidad (Malcolm)	J-STD-004B 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	120 – 220 Pa.S Típico (depende de la fórmula)	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	PASA	
Depresión (slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Bola de soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

<p>Fuerza de Adhesión (Tack)</p>	<p>J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44</p>	<p>43.8 gf Típico</p>	 <table border="1"> <caption>W20 SAC305 88.5-T4 Tack Data</caption> <thead> <tr> <th>Time in Test (hours)</th> <th>Tack (gF)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table>	Time in Test (hours)	Tack (gF)	0	50	2	53	4	46	6	51	8	49
Time in Test (hours)	Tack (gF)														
0	50														
2	53														
4	46														
6	51														
8	49														
<p>Humectación</p>	<p>J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45</p>	<p>PASA</p>													

† Uso sólo como referencia. No debe utilizarse como especificaciones de productos concretos.

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.